

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

苏州赛腾精密电子股份有限公司

投资者交流活动纪要

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 利润说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称	平安资管、浙商证券、南方基金、海富通、信达澳亚、申万菱信、交银施罗德、招商基金、银华基金、华泰柏瑞、国寿安保、汇添富、长江资管、兴业基金、兴全基金、准锦投资、方正富邦、华福证券、国信资管、天弘基金、汇丰晋信基金、东吴证券、银河基金、广发证券、太平基金、易方达、博时基金、中欧基金、中邮基金、国联基金、大家资产、建信基金
时间	2024年11月7日-2024年11月8日
地点	公司现场、上海
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理、董事会秘书：孙丰 证券事务代表：刘长艳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动中接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容概要如下：</p> <p>第一部分：公司简介及三季度经营情况介绍</p> <p>赛腾股份是一家专业提供智能制造解决方案的高新技术企业，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案。公司的核心发展思路在于立足原有 3C 大客户品类的拓展，同时积极向半导体等领域扩张。</p> <p>公司登录 A 股市场近 7 年，业务领域从刚上市时单一的消费电子板块到现在拓展到半导体、新能源等板块，营业收入由 6 个多亿上升</p>

到 44.46 亿（2023 年度），相信各位投资者通过公司的定期报告也能看到这几年公司的成长。

2024 年前三季度，公司营业收入 31.94 亿元，同比增长 21.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.75 亿元，同比增长 18.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.55 亿元，同比增长 18.01%。

第二部分：交流问答：

问题一：公司三季度收入为什么能实现大幅增长？

答：2011 年公司通过大客户合格供应商认证，从最初的整机组装检测设备拓展到现在前端的零组件组装检测设备，公司已经是大客户 3C 自动化设备核心供应商。今年公司持续获得摄像头等前端模组业务订单，在耳机、手机等终端产品业务同比去年也获得较大增长，因此前三季度收入能够实现增长，我们对全年增长也很有信心。

问题二：三季报财务费用大增的原因？今年实施了员工持股计划，股份支付跟去年比影响有多大？

答：公司前三季度财务费用与去年同期相比大增主要是受汇率波动影响，汇兑影响 5500 多万元。前三季度确认的股份支付费用同比去年增加了 5300 多万元。

问题三：展望明后年消费电子业务的增长机会？

答：明后年消费电子业务的增长机会主要有：1、摄像头模组的组装和检测设备，过去基本上是外资主导，国产替代空间巨大，同时摄像头模组持续改款创新，也提供了较大的市场增量。公司已经成功切入摄像头模组设备市场，明年有望在多种摄像头模组中拿到订单，持续扩大份额；2、AI 发展加速终端产品创新迭代，明后年是手机、手表、耳机等产品的创新改款大年，公司有望获得更多终端产品整机的组装、检测设备订单；3、终端新产品如 MR/AR 等，公司深度参与研发打样，如果明后年持续推出，会带来一定的市场增量；4、其他前端模

组业务，公司也在积极推进并有望进一步突破。综上，公司对于明后年消费电子板块还是很有信心的。

问题四：如何解释公司合同负债的大幅下降？

答：合同负债同比减少主要是消费电子板块预收账款减少，消费电子板块并不是所有的客户都会预付款项，即使同一客户不同批次的设备付款条件也可能会有所差异，合同负债会随客户付款条件变化而变化，合同负债与订单情况不是完全成比例的，公司今年订单充足。

问题五：公司 HBM 业务进展如何？

答：去年以来公司已拿到海外大客户 HBM 批量设备订单，设备已经陆续交付，部分设备已完成验收，预计明年上半年可以完成现有订单的交付。公司持续推进国内外新客户业务，后续有望取得突破。

问题六：半导体业务收入占比是多少，如何展望明后年？

答：2024 年前三季度半导体收入占比将近 12%，公司在硅片检测、晶圆边缘/背面检测、HBM 检测等环节持续取得积极进展，目前有十多个在研项目，公司对于新项目在明后年取得批量订单很有信心。

问题七：公司半导体业务在国内进展如何，后续是否考虑建设国内产能？

答：国内已经具备高端半导体设备交付能力，部分产品已经从国内生产交付。

问题八：公司成功收购过 optima，后续是否有收购打算？

答：公司拥有成功的并购经验，optima 收购后收入实现大幅增长，并且已经贡献利润。在半导体、测试等前沿科技领域，公司一直积极寻找优质标的进行合作。

问题九：公司还有哪些新的业务？

答：公司在半导体封测自动化设备领域有着丰富的技术储备，在激光打标、激光开槽等半导体封测业务端取得突破，公司已从日月光

	等客户获得批量订单。新能源板块目前虽然实现营收占比较小，但公司对其发展前景看好。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 8 日